

เอกสารอ้างอิง

1. Ali Omar,M. Elementary solid State Physics. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co., 1975.
2. Backenstoss, G. "Evaluation of The Surface Concentration of Diffused Layers in Silicon." The Bell System Technical Journal. (May 1958): 699-710.
3. Beyer, K.D. "A New Paint-On Diffusion Source!" Journal of the Electrochemical Society. (October 1976): 1556-1560.
4. Brown, W.L.,Higinbotham, W.A.,Miller,G.L. and Chase, R.L. Semiconductor Nuclear-Particle Detectors and Circuits. National Academy of Sciences,1969.
5. Burger,R.M. and Donovan,R.P. Fundamentals of Silicon Integrated Device Technology. New Jersey : Prentice-Hall,Inc.,1967.
6. Chandler,T.C.,Faust,J.W. and Hilborn,R.B. "Debris-Induced Effects from Spin-On Diffusion Sources!" Journal of Electrochemical Society. (December 1979): 2216-2220.
7. Dearnaley,G. "Nuclear Radiation Detection by Solid State Devices." Journal of Science Instrumentation. 43(1966): 6.1-6.9.
8. Dearnaley,G. and Northrop,D.C. Semiconductor Counters for Nuclear Radiations. New York : John Wiley & Sons,Inc.,1963.
9. Facchini, U.,Forte,M.,Malvicini,A and Rossini,T. "Analysis of U and Th Minerals by Alpha Spectrum." Nucleonics. 14 (September 1956): 126-131.
10. Grove,A.S. Physics and Technology of Semiconductor Devices. New York: John Wiley & Sons,Inc.,1967.

11. Hofker, W.K. "Semiconductor Detectors for Ionizing Radiation." Philips Technical Review. 27(1966):323-326.
12. Miller, G.L. "The Physics of Semiconductor Radiation Detectors." Laboratory Manual A. Semiconductor Detectors and Associated Electronics. (November 1968):1.4-1.28.
13. Moncaster, M.E., Northrop, D.C. and Raines, J.A. "A Semiconductor Monitor for Nuclear Radiations." Nuclear Instruments and Methods. 22(1963): 157-164.
14. Runyan, W.R. Semiconductor Measurements and Instrumentation. Tokyo : McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., 1975.
15. Sze, S.M. Physics of Semiconductor Devices. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1969.
16. Smits, F.M. "Measurement of Sheet Resistivities with The Four- Point Brobe." The Bell System Technical Journal. (May 1958): 711-718.
17. Wolf, F. Silicon Semiconductor Data. Hungary: Pergamon Press, Inc., 1969.
18. William Burford, B. and Gray Verner, H. Semiconductor Junctions and Devices. New York: McGraw-Hill, Inc., 1965.
19. William Price, J. Nuclear Radiation Detection. New York: McGraw-Hill Inc., 1964.
20. ORTEC Inc. "Decay Ratios for Am-241." ORTEC Application Note. U.S.A., 1971.
21. Solid-State Electronics Laboratory Manual. University of Cincinnati, U.S.A.
22. Trademark of Allied Chemical Co. Accuspin Spin-On Dopant Solutions. U.S.A., 1973.

23. Veeco Instruments Inc. Operation & Maintenance of Four Point Probe

Model FPP-100. New York.

24. Information published by Research Triangle Institute. 1 : 2-4.

25. ประมวล วงศ์ภูงา "การศึกษาและการใช้แอนโนดิคอกซ์ เทชั่น เพื่อหาอิมเพียวริตีไฟฟ้า"

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2523



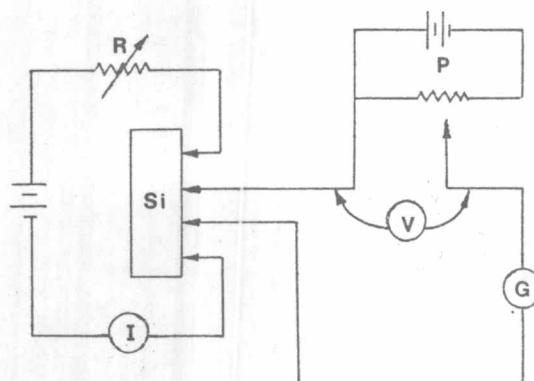
ภาคผนวก ก.

ก. 1 การวัดความต้านทานจำเพาะโดยใช้ Four-point probe

จุดประสงค์ เพื่อวัดชนิดของพาหะ และความต้านทานจำเพาะของผลึกสารกึ่งตัวนำ โดยใช้

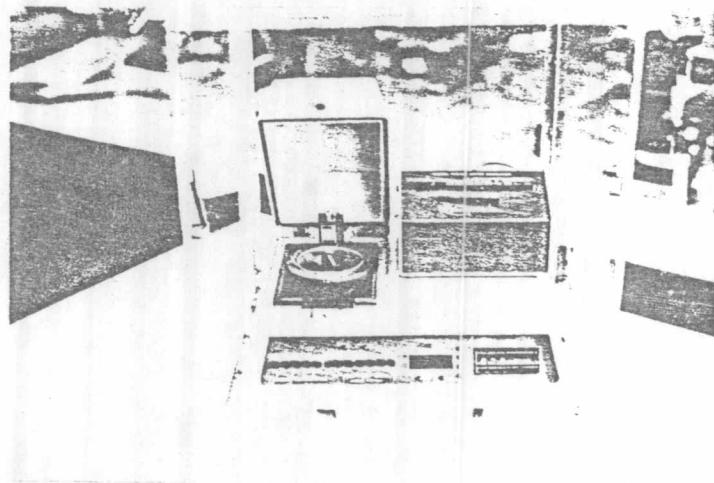
Four-point probe model FPP-100

วิธีรัดความต้านทานจำเพาะที่นิยมกันมากที่สุด คือ การใช้ Four-point probe ซึ่งประกอบด้วย probe ที่ทำด้วยโลหะจำนวน 4 ขา และวางห่างกันด้วยระยะเท่า ๆ กัน เมื่อกดให้สัมผัสถักปีบผิวเรียบผลึกพอดี จะมีกระแส I ไหลผ่าน probe 2 ขาด้านนอก และเห็นยอดใน voltage drop V คร่อม probe 2 ขาด้านใน ซึ่งสามารถวัดค่าได้โดยใช้ null-type detector ตั้งแสดงไว้ในรูปที่ ผ. 1

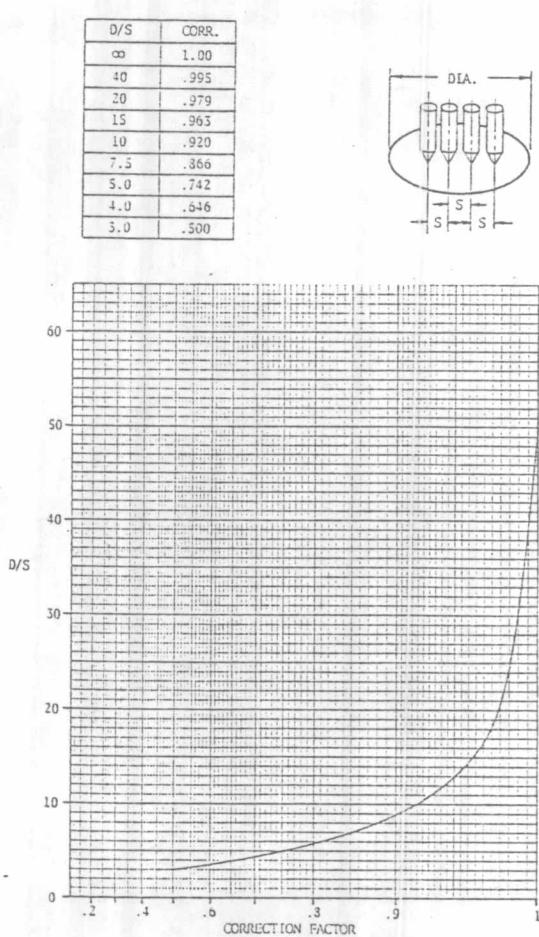


รูปที่ ผ.1 วงจรวัดความต้านทานจำเพาะโดยใช้ Four-point probe⁽²¹⁾

สำหรับ Four-point probe model FPP-100 มีลักษณะทั้งรูปที่ ผ. 2 และเป็นไปในการใช้งานได้แสดงไว้ในรูปที่ ผ.3



รูปที่ ผ.2 Four-point probe model FPP-100

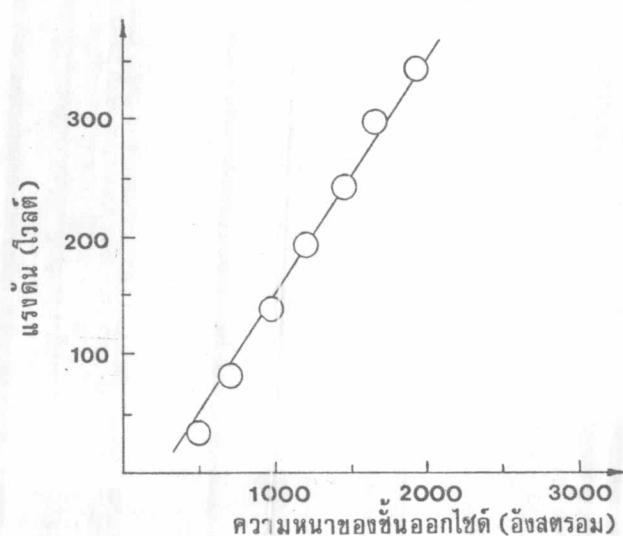


รูปที่ ผ.3 Geometry correction⁽²³⁾

ก. 2 การวัดความลึกของหัวต่อพี-เอ็นโดยวิธีแอนโนดิคออกซิเดชัน (25)

จุดประสงค์ เพื่อหาความลึกของหัวต่อพี-เอ็น โดยอาศัยหลักการลอกผิวชั้นแร่ร่องรอย

แอนโนดิคออกซิเดชันเป็นกระบวนการแบบเคมีไฟฟ้า (Electrochemical) เพื่อใช้สร้างชั้นออกไซด์ที่ขึ้นแอนโนด ความเร็วในการสร้างชั้นออกไซด์ ความหนาของชั้นออกไซด์และคุณภาพของชั้นออกไซด์ควบคุมได้จากปริมาณความหนาแน่นของกระแส แรงดันคร่อมขั้วอิเลคโทรดทั้งสองและความเข้มข้นของสารละลายอิเลคโทรไลท์ที่ใช้ปัจจุบันนี้มีปริมาณต่าง ๆ กัน จากผลการสร้างชั้นออกไซด์แบบแอนโนดิคออกซิเดชัน ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับความหนาของชั้นออกไซด์ (ดังรูปที่ ผ. 4) นอกจากนั้นแอนโนดิคออกซิเดชันยังมีข้อดีคือ เป็นการสร้างชั้นออกไซด์โดยไม่ใช้ความร้อน ตั้งนั้นจึงไม่เกิดการ redistribution ของสารเจือปนที่แร่ร่องรอยในระหว่างกระบวนการสร้างชั้นออกไซด์ด้วย จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้หาความลึกของหัวต่อ กล่าวคือห้องจากสร้างชั้นออกไซด์ให้มีความหนาตามความเหมาะสมแล้ว ก็นำไปลอกชั้นออกไซด์ออกด้วยสารเคมีแล้ววัดค่าความต้านทานจำเพาะโดยใช้ Four-point probe บันทึกค่าเอาไว้ ต่อจากนั้นก็นำไปสร้างชั้นออกไซด์ซ้ำอีก จนกระทั่งค่าความต้านทานจำเพาะที่วัดได้ใกล้เคียงกับความต้านทานจำเพาะของแร่ร่องรอย ก็อ่าว่าตำแหน่งนั้นคือความลึกของหัวต่อ และเนื่องจากไม่มีความร้อนเข้ามาทำให้เกิดการ redistribution ตั้งนั้นความลึกของหัวต่อที่วัดได้นี้จึงเป็นค่าที่แท้จริง



รูปที่ ผ. 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันคร่อมขั้วแอนโนด-ค่าโทคกับความหนาของชั้นออกไซด์⁽²⁵⁾

ในการทดลองนี้กำหนดให้สร้างขั้นอ็อกไซด์แต่ละครั้งหนาประมาณ 1000 \AA ระบบเครื่องมือที่ใช้แสดงในรูปที่ ผ. 5 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สารละลายนิเลคโตรไรล์ มีส่วนผสมของ

- ethylene glycol	205	ลบ.ซม.
- น้ำ	20	ลบ.ซม.
- KNO_3 หนัก	1	กรัม

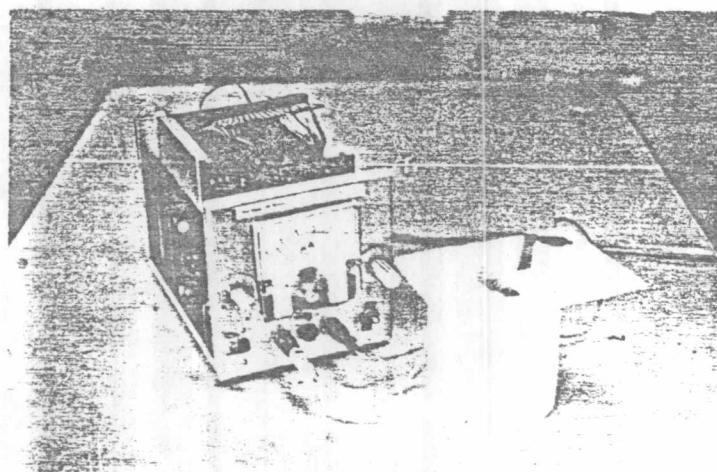
แรงดันที่ใช้สร้างอ็อกไซด์หนา 1000 \AA มีค่าเท่ากับ 50 โวลต์ (รูปที่ ผ. 4)

กระแสเมื่อเท่ากับ 7 มิลลิแอมป์

ขั้วแอนโนด-คาโทดอยู่ห่างกัน 2 ซม.

ขั้นอ็อกไซด์ที่ได้จะเป็นสีม่วง (violet)

เมื่อได้ขั้นอ็อกไซด์หนาตามความต้องการแล้วก็นำไปกัดอ็อกไซด์ออก ต่อจากนั้นใช้ Four-point probe วัดค่าความต้านทานจำเพาะของแวนพลีก แล้วนำไปสร้างขั้นอ็อกไซด์หนา 1000 \AA ซ้ำอีก จนกว่าจะได้ค่าความต้านทานจำเพาะใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้ก่อนการแพร่ชีมจึงหยุดสร้างขั้นอ็อกไซด์ ความลึกของหัวต่อหาได้จากการรวมของความหนาของขั้นอ็อกไซด์ทั้งหมดคุณด้วยผลร้อยละ $0.42^{(10)}$



รูปที่ ผ.5 ระบบเครื่องมือสร้างขั้นอ็อกไซด์ด้วยวิธีแอนโนดิกออกซิเดชัน

ก. 3 การวัดความลึกของหัวต่อฟี-เอ็นโดยวิธีเช่าร่อง⁽²¹⁾

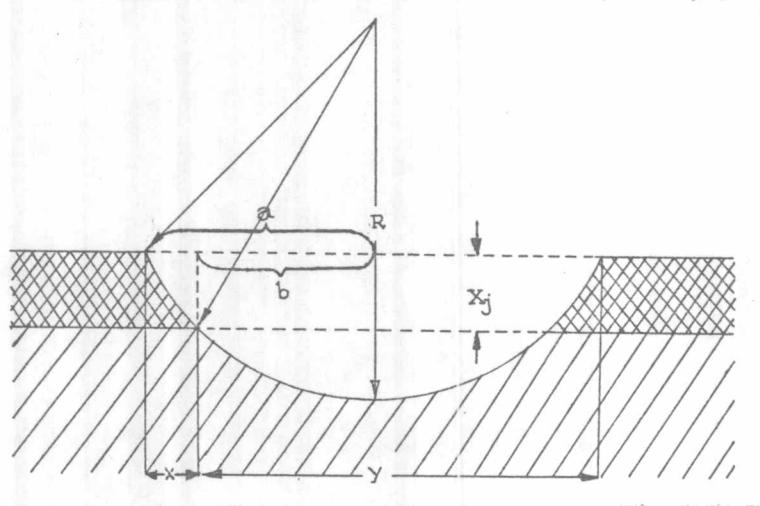
จุดประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของหัวต่อฟี-เอ็น โดยอาศัยการย้อมสี และวัดความลึกของหัวต่อโดยใช้กล้องไมโครสโคป

สารเคมี วัสดุ และ เครื่องมือ

1. Hydrofluoric Acid, 49%, Electronic Grade
2. Nitric Acid, Conc., Electronic Grade
3. Tri chloro ethylene (TCE) Electronic Grade
4. Acetone
5. D.I. Water
6. Apeizon wax
7. $0.3\mu \text{ Al}_2\text{O}_3$ lapping powder
8. Hot plate
9. A grooving equipment
10. Microscope

การวัดความลึกของหัวต่อโดยใช้สารเคมีในการย้อมสินั่นก์ เพื่อแยกชั้นของรอยต่อออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนปฏิกริยาที่เกิดขึ้นบนชั้นเอ็น และชั้นพี เป็นไปด้วยอัตราความเร็วที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นสีที่ปรากฏบนผิวแวร์ผลลัพธ์จึงแตกต่างกัน ทำให้เกิดเส้นแบ่งเขตชั้น เป็นการบ่งบอกถึงตำแหน่งของหัวต่อฟี-เอ็น

สำหรับการทดลองนี้ได้ทำการซัดผิวของแวร์ผลลัพธ์จิลกอนโดยใช้วิธีเช่าร่อง (grooving) เพื่อวัดหาความลึกของหัวต่อ วิธีนี้หมายความว่าสำหรับหัวต่อตื้น ๆ โดยใช้แท่งทรงกระบอกชุดๆ ตามที่ต้องการ ของชั้นแวร์ชิมให้เป็นรูปล่าวๆ ดังแสดงไว้ในรูปที่ ผ. 6 แกนของทรงกระบอกที่ใช้ชัดต้องตรงไว้ไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่ง



รูปที่ ผ.6 พื้นที่ภาคตัดขวางของแวนพลีกที่ถูกขัดผิวโดยวิธีเช่าร่อง (21)

จากรูปสามารถคำนวณหาความลึกของหัวต่อได้ดังนี้

$$x_j = \sqrt{R^2 - b^2} - \sqrt{R^2 - a^2}$$

$$= \frac{xy}{D}$$

ในที่นี้ $D = 2R =$ เส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งทรงกระบอกที่ใช้ขัด

การทดลอง

ขั้นตอนการ เช่าร่องมีดังนี้

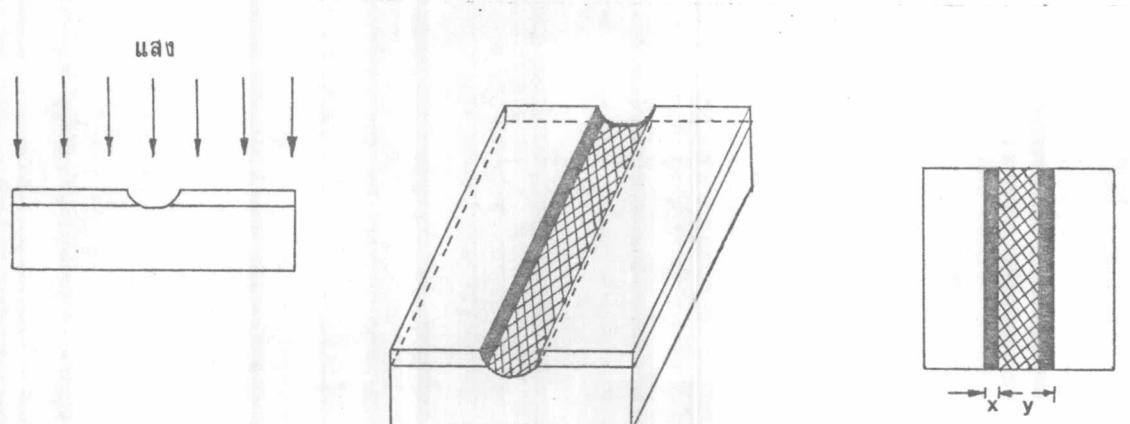
1. นำแวนพลีกชิลิกอนที่ผ่านขั้นตอนการแพร่ชีมมาแล้วติดลงบนแผ่นโลหะที่ร้อนและมี wax ทาติดอยู่เป็นแผ่นบาง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
2. ทำแผ่นโลหะร้อนให้เย็น โดยแช่ส่วนล่างลงในน้ำประมาณ 2-3 นาทีแล้วเปาให้แห้งด้วย N_2 เตรียมไว้สำหรับขัดผิว

3. ทำผง Al_2O_3 ซึ่งอยู่ในลักษณะ เป็นของเหลวลงบนแท่งทรงกระบอกที่ใช้เป็นตัววัด
4. นำแวนเพล็กที่ติดอยู่บนแผ่นโลหะเข้าสู่แท่นยีด และปรับให้ผิวของแวนเพล็กแนบสนิท กับแท่งทรงกระบอกพอดี
5. เปิดสวิตช์ให้แท่งทรงกระบอกหมุน ใช้เวลาชุดประมาณ 20-30 นาที
6. แกะแวนเพล็กออกจากแผ่นโลหะ เตรียมพร้อมสำหรับการย้อมสี

ขั้นตอนการย้อมสีมีดังนี้

1. ผสมน้ำยาเคมีที่ใช้สำหรับย้อมสีประกอบด้วย fuming HNO_3 2-3 หยดผสมกับ HFconc. 10 มิลลิลิตร
2. นำแวนเพล็กที่ผ่านการเช่าร่องล้างให้สะอาดด้วย Trichloro ethylene, Acetone และน้ำ D.I. แล้วนำไปให้แห้งด้วย N_2
3. หยดน้ำยาบ้มสีลงบนรอยชัด รอประมาณ 3-5 วินาที
4. ล้างด้วยน้ำ D.I. แล้วนำไปแห้งด้วย N_2 นำไปปล่องด้วยกล่องไมโครสโคป

การวัดความลึกของหัวต่อโดยใช้กล้องไมโครสโคปนั้น ต้องให้แสงที่มีความถี่เดียว (monochromatic light) ตกกระทบตั้งจากกับแวนเพล็กซิลิกอน แสงสะท้อนที่มองเห็นด้วยกล้องไมโครสโคปจะมีลักษณะเป็นแถบสีที่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างน้ำยาบ้มสี กับชนิดของสารเจือปน ซึ่งได้แสดงไว้ดังรูปข้างล่างนี้



(21)
รูปที่ ผ.7 ลักษณะของแถบสีที่ปรากฏหลังการย้อมสี

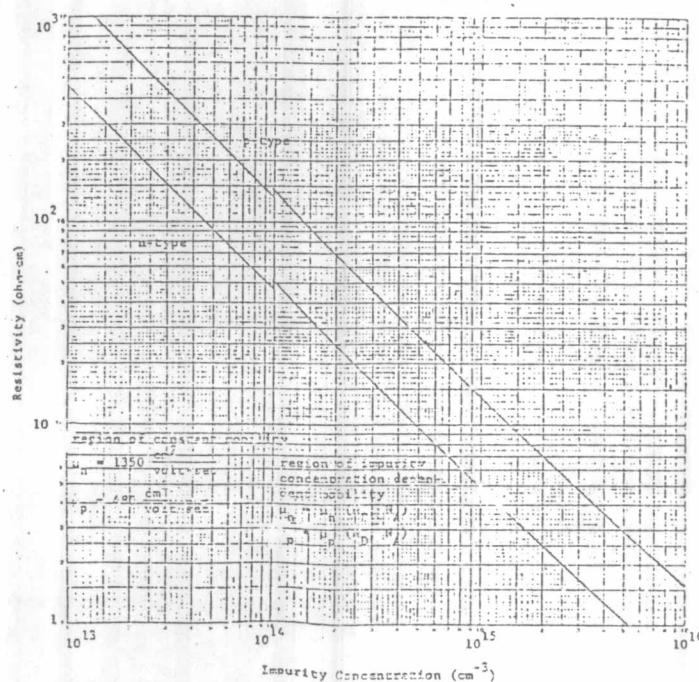
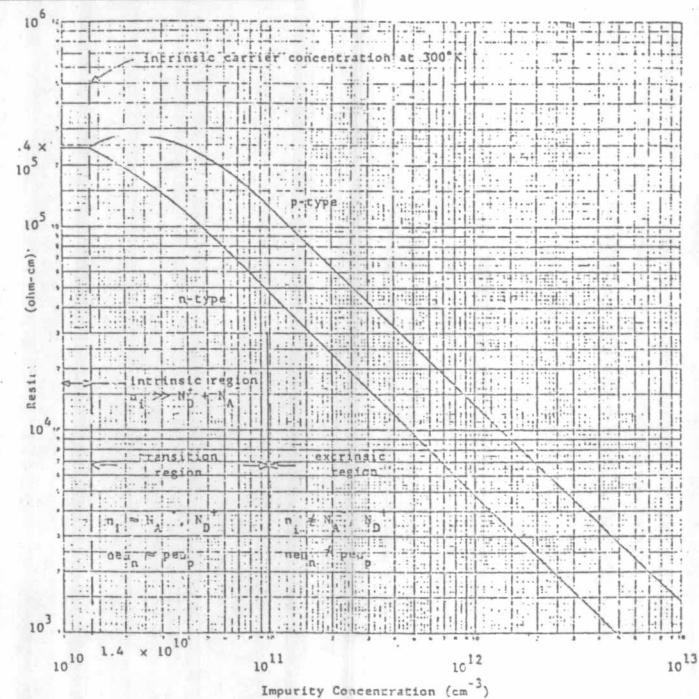
วัดค่า x และ y โดยใช้กล้องไมโครสโคป แล้วนำมาคำนวณหาความถี่ของหัวต่อจากสูตร

$$x_j = xy/D$$

จากวิธีการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เราจึงสามารถวัดความถี่ของหัวต่อพี- เอ็นได้โดยใช้วิธีเข้าร่อง

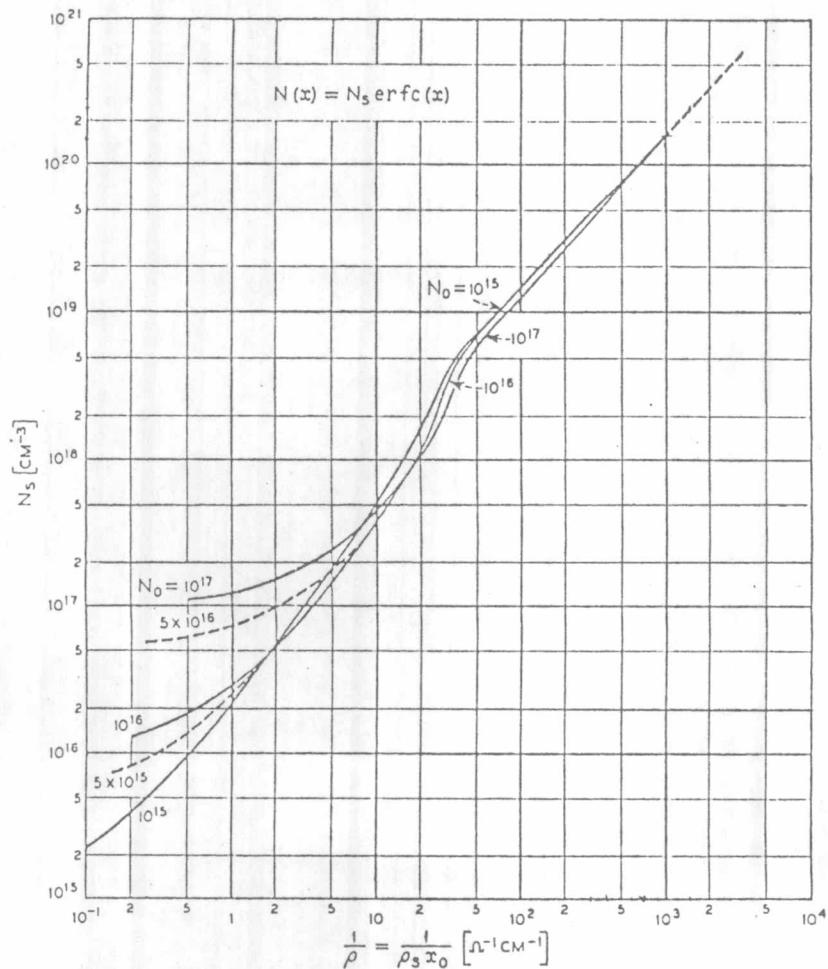
ภาคผนวก ข.

ข. 1 การหาค่าความเข้มข้นของพาหะของชิลิกอน



รูปที่ ผ.8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานเจ เพาะกับค่าความเข้มข้นของพาหะของชิลิกอนที่อุณหภูมิ 300 K⁽²⁴⁾

ข. 2 การหาค่าความเข้มข้นของพาร์เซิ่มนิวเคลียริกอน



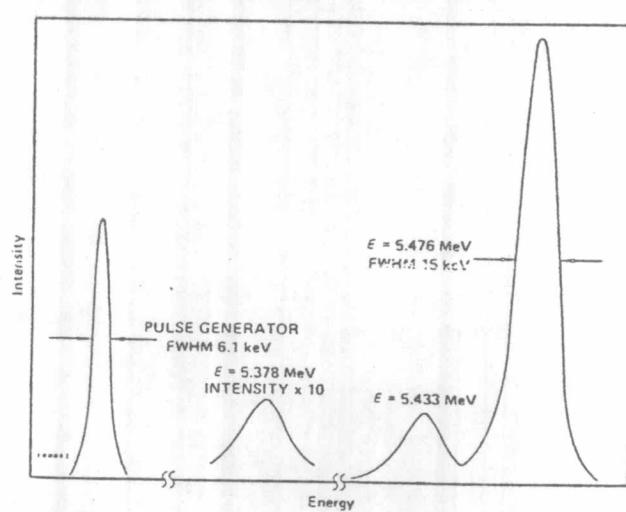
รูปที่ ผ.9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิ่งจำเพาะ
 พาร์เซิ่มนิวเคลียริกอน (N_s) สำหรับขั้นพาร์เซิ่มนิวเคลียริกอนและเป็นแบบ complementary
 error function distribution

(1) กับค่าความเข้มข้นของ

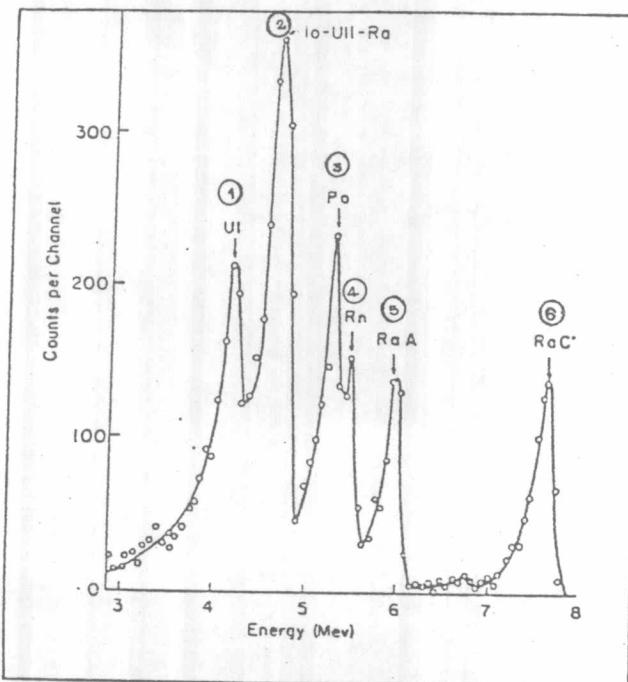
(2)

ภาคผนวก ค.

ค. 1 สเปกตรัมของรังสีอเมอริเซียม ($\text{Am}-241$) และเรเดียม ($\text{Ra}-226$)



รูปที่ ผ.10 สเปกตรัมของรังสีอเมอริเซียม (20)



รูปที่ ผ.11 สเปกตรัมของรังสีเรเดียม (9)

จากรูปที่ ผ. 11 ธาตุยูเรเนียม (U-238) จะถลวยหัวให้ราดต่าง ๆ อีกหลายชนิด และรับสีของแต่ละธาตุมีค่าพลังงานดังต่อไปนี้

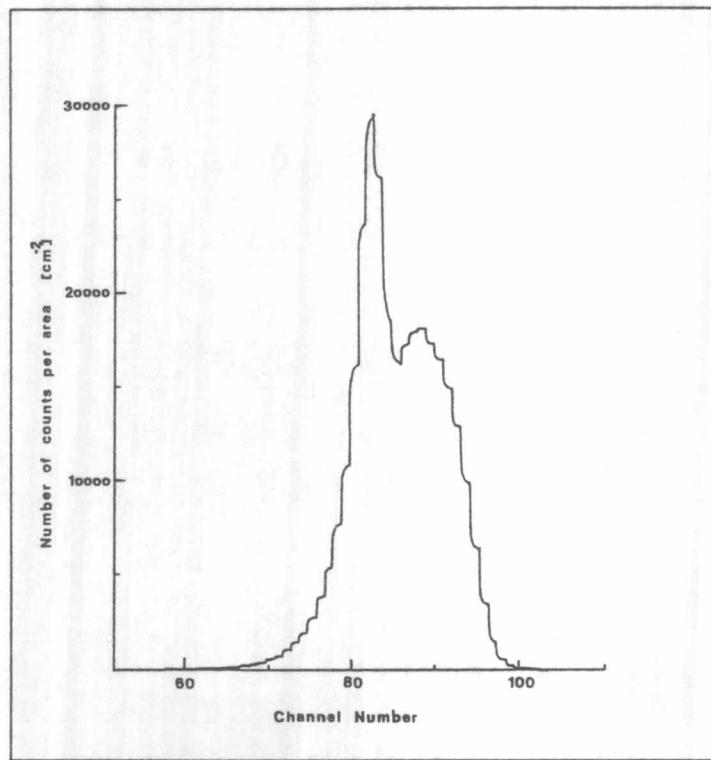
ยอดที่ 1	U-238	พลังงาน	4.20 MeV
ยอดที่ 2	Ra-226	พลังงาน	4.78 MeV
ยอดที่ 3	Po-210	พลังงาน	5.30 MeV
ยอดที่ 4	Rn-222	พลังงาน	5.49 MeV
ยอดที่ 5	Po-218 (RaA)	พลังงาน	6.00 MeV
ยอดที่ 6	Po-214 (RaC ⁺)	พลังงาน	7.69 MeV

ค. 2 ตัววัดรังสีอัลฟ่ามาตรฐานแบบ surface barrier

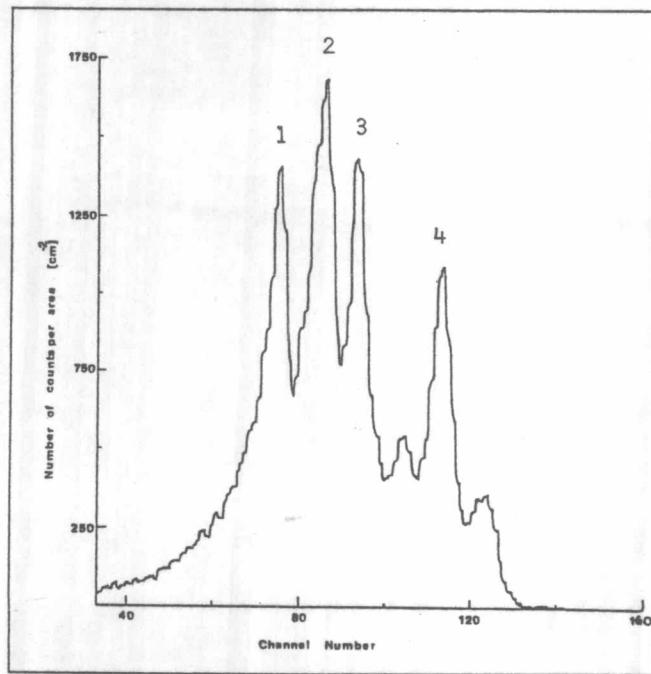
รูปร่างลักษณะของตัววัดรังสีอัลฟ่าแบบ surface barrier ที่ล้ำชื่อจากต่างประเทศได้แสดงไว้ดังรูปที่ ผ. 12 เมื่อนำไปทดสอบกับรังสีอเมอริเซียม (Am-241) และเรเตียม (Ra-226) (แหล่งกำเนิดเป็นแบบ point source) จะให้ผลตอบสนองทางรังสีดังรูปที่ ผ. 13 และ ผ. 14 ตามลำดับ สำหรับข้อมูลที่ได้จากการทดสอบสรุปไว้ในตารางที่ ผ. 1



รูปที่ ผ. 12 ตัววัดรังสีอัลฟ่ามาตรฐานแบบ surface barrier



รูปที่ ผ.13 ผลตอบสนองทางรังสีของตัวรับด้า แบบ surface barrier ที่มีค่ารังสีอเมอร์เรียน



รูปที่ ผ.14 ผลตอบสนองทางรังสีของตัวรับด้า แบบ surface barrier ที่มีค่ารังสีเรเดซิยัม

ตารางที่ ผ.1 คุณสมบัติทางรังสีของตัววัดรังสีอัลฟ์มาตรฐานแบบ surface barrier

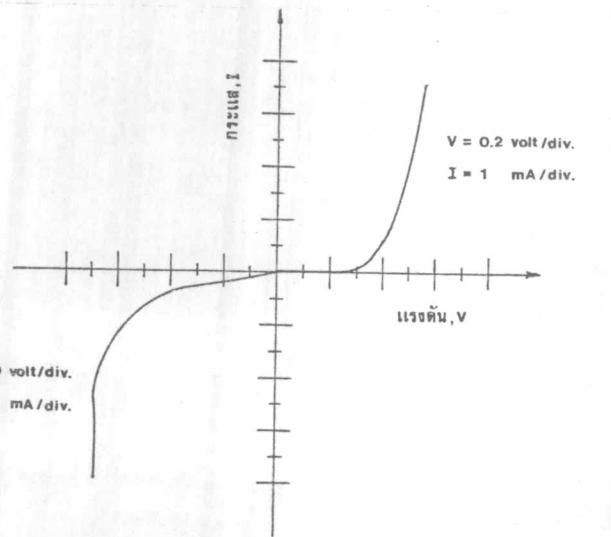
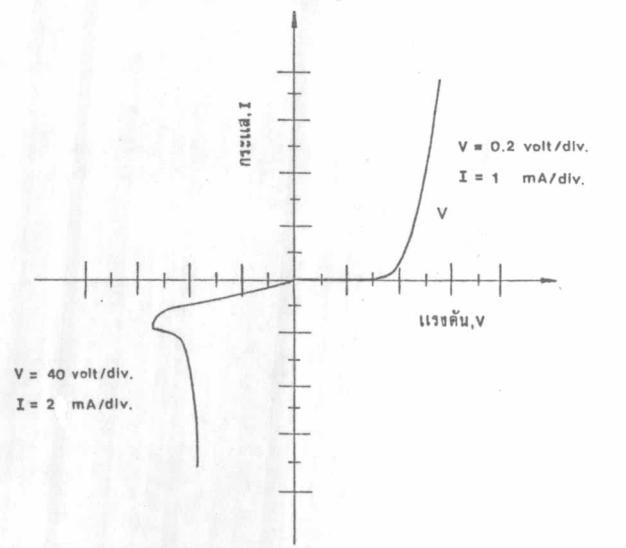
พื้นที่รับรังสี (ตร.ชม)	แรงตันไบแอดย้อน ที่เหมาะสมในการใช้งาน (โวลต์)	จำนวนนับปริมาณรังสี อเมอเรชียนต่อ ตร.ชม.	FWHM (keV)	จำนวนนับปริมาณรังสี เร เตียงต่อ ตร.ชม.			
				ยอดที่ 1 4.78 MeV	ยอดที่ 2 5.30 MeV	ยอดที่ 3 6.00 MeV	ยอดที่ 4 7.69 MeV
2	50	29902	313	1417	1701	1440	1094

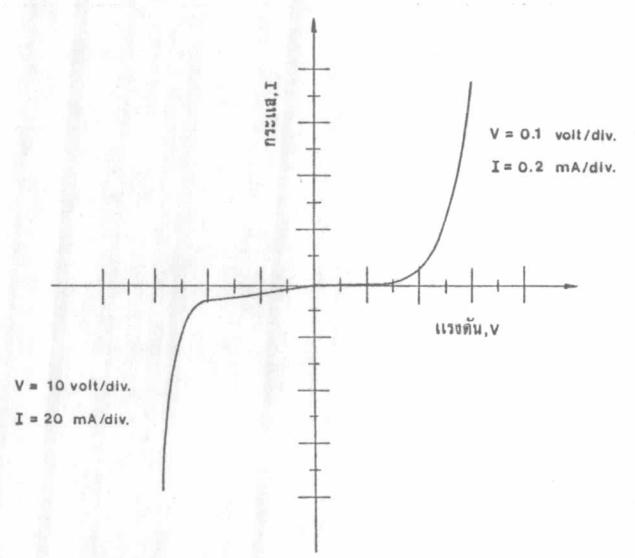
หมายเหตุ แหล่งกำเนิดรังสีและตัววัดฯ อยู่ห่างกัน 1 ชม.

ภาคผนวก ง.

ง. 1 ลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันของตัววัดรังสีอัลฟ่าทั้ง 3 ตัวอย่างที่สร้างขึ้น

ผลจากการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของตัววัดฯ ทั้ง 3 ตัวอย่าง ปรากฏว่าได้ลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันดังรูปที่ ผ. 15

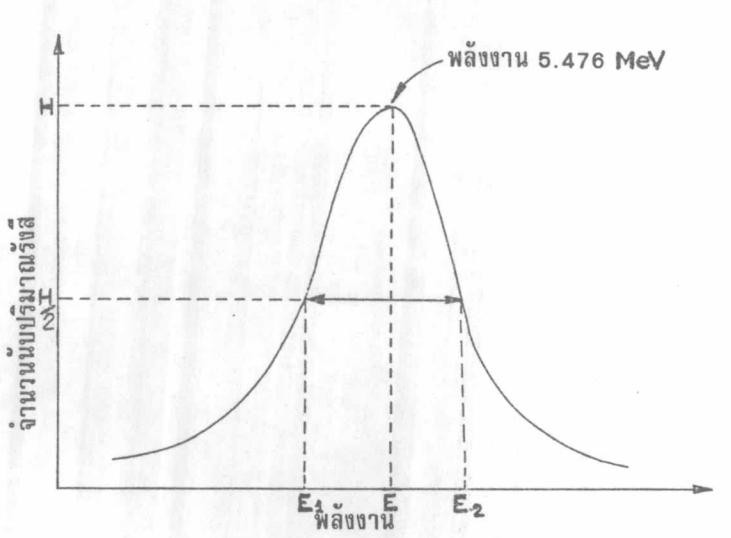




รูปที่ ผ.15 ลักษณะสมบัติการะแส-แรงดันตัววัดรังสีอัลฟ่าทั้ง 3 ตัวอย่างที่สร้างขึ้น

ง. 2 วิธีคำนวณหาค่า Full Width at Half Maximum (FWHM)

นำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบผลตอบสนองทางรังสีของตัววัดรังสีอัลฟ่าทั้ง 3 ตัวอย่างมาเขียนกราฟ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของอนุภาคอัลฟ่ากับจำนวนนับปริมาณรังสี (number of counts) รูปกราฟที่ได้จะเป็นสเปกตรัมของรังสีที่ใช้ทดสอบ สำหรับในงานวิจัยนี้เป็นสเปกตรัมของอเมอรีเซียม ($\text{Am}-241$) ซึ่งอนุภาคส่วนใหญ่มีพลังงาน 5.476 MeV (สเปกตรัมมีเพียงยอดเดียว) ดังแสดงในรูปที่ ผ. 16



รูปที่ ผ.16 สเปกตรัมของอเมอรีเซียมสำหรับใช้หาค่า FWHM

ค่า FWHM ก็คือ ความกว้างของสเปกตรัมที่ต่ำเท่านั้นๆ ของจำนวนนับปริมาณรังสีที่รักได้ทั้งหมดภายในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดังนั้นจากรูปที่ ผ. 16 จะเห็นว่า FWHM มีค่าเท่ากับ $E_2 - E_1$ ค่านี้เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของตัววัดฯ ว่ามีความสามารถในการแยกพลังงานได้มากน้อยเพียงใด ค่า FWHM ยิ่งน้อย ความสามารถในการแยกพลังงานของตัววัดฯ จะยิ่งดีขึ้น เป็นลำดับ

ง. 3 วิธีคำนวณหาความกว้างของเขตปลดพาราห์

ความกว้างของเขตปลดพาราห์สามารถคำนวณได้จากค่าความจุของหัวต่อพี-เอ็น โดยอาศัยสมการที่ (2.37) คือ

$$C = \frac{\chi A}{4\pi x}$$

$$x = \frac{\chi A}{4\pi C}$$

ในที่นี้ x คือ ความกว้างของเขตปลดพาราห์ มีหน่วยเป็น ซม.

C คือ ความจุของหัวต่อพี-เอ็น มีหน่วยเป็น pF

χ คือ dielectric constant ของชิลิกอน มีค่าเท่ากับ 11.7

A คือ พื้นที่รับรังสีของตัววัดฯ มีหน่วยเป็น ตร.ซม.

ตัวอย่างการคำนวณ

ให้คำนวณหาความกว้างของเขตปลดพาราห์ของตัววัดรังสี ในเมื่อป้อนแรงดันไฟแอลบิอน 100 โวลต์ให้กับตัววัดฯ และทำให้มีค่าความจุของหัวต่อเท่ากับ 30 pF พื้นที่รับรังสีของตัววัดฯ เท่ากับ 1 ตร.ซม.

จากสูตร

$$x = \frac{\chi A}{4\pi C}$$

$$= \frac{11.7 \times 1}{4\pi \times 30}$$

$$= 0.0310 \text{ ซม.}$$



ประวัติผู้เขียน

นาย พรพิทักษ์ โพธิเวชกุล เกิด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาชั้นปัฒนิติศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อปี พ.ศ. 2522 และเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาบัณฑิต ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในขณะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัยในการประกวดและแสดง
นิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัย-
มกيدล ในปี พ.ศ. 2523